

欣銓科技股份有限公司

Credit Suisse Asian Technology Conference 2009

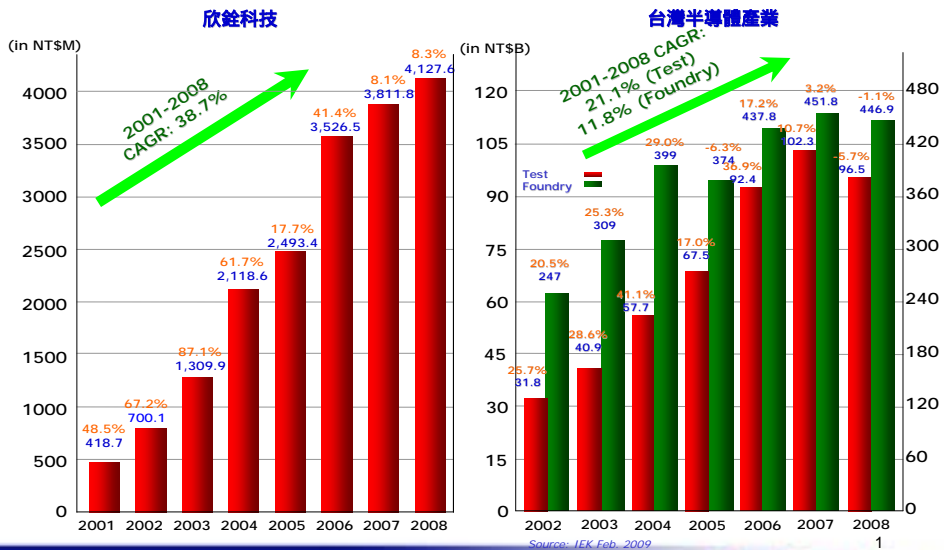
總經理：張季明 博士

Sep. 16, 2009

Innovative Testing

Ardentec

營收成長



Innovative Testing

Ardentec

H1/2009營收狀況

欣銓(臺灣)

單位：新台幣仟元

	Revenue this period	Revenue previous period	QoQ HoH	Revenue this period/2008	YoY
1Q ' 09	327,929	758,712	(56.8%)	1,049,058	(68.7%)
2Q ' 09	681,788	327,929	107.9%	979,229	(30.4%)
H1 ' 09	1,009,717	1,875,260	(46.2%)	2,028,287	(50.2%)

欣銓(合併)

單位：新台幣仟元

	Revenue this period	Revenue previous period	QoQ HoH	Revenue this period/2008	YoY
1Q ' 09	358,165	806,044	(55.6%)	1,107,994	(67.7%)
2Q ' 09	743,125	358,165	107.5%	1,026,618	(27.6%)
H1 ' 09	1,101,290	1,992,953	(44.7%)	2,134,612	(48.4%)

2

Innovative Testing

Ardentec

H1/2009損益表比較 (合併)

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

	H1/2009	%	H1/2008	%	YoY(%)	H2/2008	%	HoH(%)
營業收入	1,101,290	100	2,134,612	100	(48.4)	1,992,953	100	(44.7)
營業成本	1,124,265	102	1,305,509	61	(13.9)	1,302,555	65	(13.7)
營業毛利	(22,975)	(2)	829,103	39	(102.8)	690,398	35	(103.3)
營業費用	113,656	11	167,471	8	(32.1)	180,158	9	(36.9)
營業淨利	(136,631)	(13)	661,632	31	(120.7)	510,240	26	(126.8)
營業外收支	(11,693)	(1)	(7,485)	0	56.2	(4,361)	(0)	168.1
稅前淨利	(148,324)	(14)	654,147	31	(122.7)	505,879	26	(129.3)
所得稅利益(費用)	8,313	1	(100,769)	(5)	(108.2)	(50,313)	(3)	(116.5)
本期淨利	(140,011)	(13)	553,378	26	(125.3)	455,566	23	(130.7)
每股盈餘(元)	(0.33)		1.31			1.08		

3

Innovative Testing

Ardentec

半導體製造鏈相關公司參考數據

單位：新台幣仟元；EPS、收盤價：元

	2008			H1/2009			2009/9/10 收盤價
	Revenue	ROE	EPS	Revenue	YoY	EPS	
晶圓代工							
A	333,157,660	20.7%	3.86	113,711,840	(35.2%)	1.01	63.50
B	96,813,546	(10.6%)	(1.70)	34,073,991	(34.1%)	(0.52)	15.55
C	16,120,247	4.8%	0.61	5,121,651	(43.7%)	(0.41)	14.15
凸塊							
D	5,263,712	1.3%	0.25	1,974,119	(35.9%)	(0.30)	26.60
成品封裝/測試							
E	94,430,912	8.9%	1.14	34,278,126	(31.9%)	0.02	27.00
F	62,402,934	9.8%	2.03	24,300,265	(23.2%)	0.62	46.30
G	8,333,877	16.7%	3.10	3,552,589	(21.4%)	0.85	32.55
H	31,188,982	33.3%	10.38	13,121,898	(13.3%)	2.96	96.00
晶圓測試							
I	14,635,904	1.1%	0.19	4,894,249	(37.5%)	(1.25)	12.15
J	3,891,313	5.8%	1.04	1,607,808	(16.2%)	0.42	17.15
欣銓	4,127,565	15.7%	2.53	1,101,290	(48.4%)	(0.33)	17.95

4

Innovative Testing

Ardentec

良好的財務比率 (臺灣)

年度	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	H1/2009
流動性比率								
流動比率	172%	173%	226%	177%	218%	201%	254%	228%
速動比率	165%	168%	215%	167%	206%	195%	250%	224%
資產管理比率								
固定資產週轉率	0.26	0.43	0.60	0.57	0.68	0.65	0.71	0.39
總資產週轉率	0.21	0.33	0.43	0.40	0.46	0.42	0.43	0.23
負債管理比率								
負債比率	51.0%	46.5%	31.3%	35.9%	29.6%	31.6%	27.0%	26%
利息保障倍數	0.34	3.90	10.08	14.30	19.19	15.96	17.81	(5.57)
獲利性比率								
毛利率	10.7%	33.1%	45.3%	40.9%	42.2%	39.0%	39.9%	2.1%
總資產報酬率	2.7%	11.4%	17.3%	13.7%	15.0%	12.3%	11.8%	(1.4%)
股東權益報酬率	0.3%	17.6%	25.2%	19.3%	21.1%	16.6%	15.7%	(2.2%)
每股盈餘(元)	0.03	1.78	3.00	2.62	3.05	2.62	2.53	(0.33)

5

Innovative Testing

Ardentec

競爭優勢

- 與客戶群中的晶圓製造工程師、產品測試工程師及產品設計工程師有相同的語言
- 欣銓的品質系統能夠迅速處理大量的測試資訊，滿足客戶的質與量之需求
- 欣銓透過web enabled WIP/EDAS等IT系統，能夠提供即時且透明的訊息回饋
- 欣銓擁有服務國際級一流大廠的系統與經驗
- 欣銓擁有臺灣最大的12吋晶圓測試產線，足以服務世界級的客戶
- 欣銓在新加坡已建置好營運中心能夠提供客戶群更寬廣及彈性的服務

良好的測試服務品質提供者

- 2008年1月榮獲美商新帝公司(SanDisk)2007年傑出商務夥伴獎(Outstanding Business Partner Award)
- 2008年2月榮獲ISO27001資訊安全管理系統(Information Security Management System)認證
- 2008年8月榮獲創意電子最佳夥伴
- 2008年12月榮獲中華公司治理協會認證通過所頒發之「CG6004 公司治理制度評量」證書
- 2009年8月榮獲國貿局頒發97年度進出口績優廠商第19名

系統封裝/裸晶測試技術的領先廠商

追求摩爾定律，系統封裝正是趨勢

- 在趨向高度整合、SiP測試需求、異質多功能整合的無線元件市場，KGD (Known-Good-Die) 測試的需求與重要性日益增加
- KGD 測試是目前主要的解決方案，因為沒有其他方式可以滿足在SiP 形式下所有的測試需要

欣銓在KGD測試技術的貢獻

- **可靠性及品質篩選流程**
 - 晶圓級預燒
 - 應用統計技術的品質篩選程序(outlier process) 以及特定樣式異常的篩選
- **良率改善製程**
 - 雷射修補
 - 類比信號微調
 - 註記編碼
- **高整合測試流程**
 - 作業管制自動化IT系統
- **節省成本方案**
 - 高並測數
- **高速測試**
 - 可測試設計之結構測試
- **低功率及 & 行動性**
 - 低溫及漏電流測試
- **晶圓製程線距微縮**
 - 12吋晶圓針測
 - 錫墊微距產品 (Fine Pad Pitch) 針測
 - 微距融絲 (Fine Link Pitch) 雷射修補
 - Low-k 銅製程錫墊針測

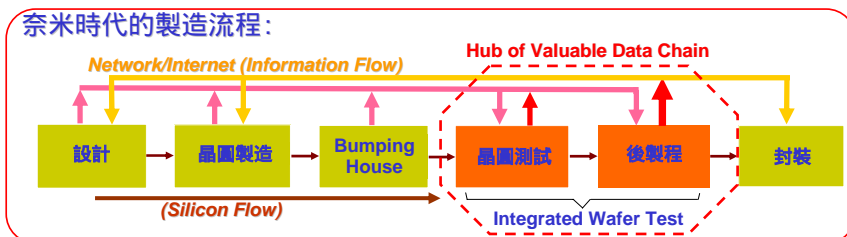
8

Innovative Testing

Ardentec

在新興的價值鏈上扮演處理中心的角色

- 進入奈米時代，欣銓在後段流程中建立一個 ”後製程” (Post-Process)
- 整合設計、製造、測試之所有數據，用以篩選 IC
- 經由資訊高速公路，提供最廣泛的測試數據
- 在有價值的數據鏈上扮演 “處理中心” 的角色



9

Innovative Testing

Ardentec